DEVICE FOR PLATING PRINTED CIRCUIT SUBSTRATE

Patent Number:

JP52056369

Publication date:

1977-05-09

Inventor(s):

SHIOSHIMA MASARU; MUTOU HACHIROU

Applicant(s):

NIPPON ELECTRIC CO

Requested Patent:

JP52056369

Application Number: JP19750133496 19751105

Priority Number(s): JP19750133496 19751105

IPC Classification:

C25D7/00; H05K3/00; H05K3/10

EC Classification:

Equivalents:

JP1206367C, JP58036514B

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - 12

file://C:\Documents%20and%20Settings\bepatterson\My%20Documents\espacenet\JP520... 6/23/2004



許 願(/)



(19) 日本国特許庁

公開特許公報

特許庁長官殿

祭 明 の名称



超和 月

ソウチ ブリント 配 線 基 板水の めっき 装 置

東京都港区芝五丁目33番1号 自未會依株式会社内

シオシマ

塩 島

東京都港区芝五丁目33番 (423) 日本電気株式会社出版点 小林安治

代表者

ተቲ

〒108 東京都港区芝五丁目33番 1号 日本電気株式会社内

(6591) 弁理士 内原 電話 東京(03)454-1111(大代表)

添付審額の目録

委任状 順 會 副本

1通



50 133496

①特開昭 52-56369

43公開日 昭 52. (1977) 5 9

50-133496 21)特願昭

昭to (1974) ②出願日

審查請求 未請求 (全5頁)

广内整理番号

5334 57

62日本分類

(51) Int. C12 HD5K 3/10 MO5K 3/00 設別 記号

7/00 C250

停許請求の範囲

プリント配額基板へのめつき装置において、基 複を一定速度で移送する基板搬送部と、光源11. 16, 集光器 12, 16 かよび光電素子 14, 18 を前 配基板の両領に配置し、前配基板表面のプリント 配級パターンのめつき面積を検出する第1, 第2 面積検出部と、前配第1, 第2面積検出部と一定 間隔をおいて配置し、光源19と集光器20およ び光電素子22とを前記基板の両側に相対向させ、 **前記基板のメルーホール内面のめつき面積を検出** する度8面積積出部と、 横瀾定國路に各▲接続し、面積彌定のための定数 を設定する第1。第2515第8定数設定部と、 前記編1、第2をよび第8面積測定回路に接続し、 各々の面積衡定回路から入力される面積値を加算

するめつき面積加算器と、前配めつき面積加算器 とめつき電源に接続し、めつき電流を制御するコ ントローラと、前記コントローラに接続し、めつ き面積に対応しためつき電流値を設定する第4定 数設定部と、めつき電源に接続し、前配基板搬送 とを梅根とするブリント配練基板のめつき袋筐。

発明の詳細な説明

本祭明は、プリント配線基板(以下基板という) へのめつき袋童において、めつき面積を自動的に 御足してめつき条件を設定するプリント配線基板 のめつき装置に関するものである。

従来一般に、基板の製造工程のうち、めつきが 主要な工程を占めている。このめつき工程におい て、精度的にも能率的にも問題の多いめつき面検。 の創定を正確かつ迅速に行なりことが要求され、 これはめつき時間と共にめつき品質の食否を左右 するめつま世疣をコントロールする重要を備であ る。ところで、この基板のめつき電流はめつき面

次に、(2)基板上のスリーホールの数、径および 板厚からスルーホール内の面積を机上計算で求め る。次に、(3)前述(1), (2)を加算して基板毎のめつ き面積の轉和を求める。等の非能率な手段により 求めためつき面積によりめつき装置の電源へめつ き電液の条件を設定していた。一方、とのよりに して求めためつき面積は精度が悪いため、めつき

次に本発明の一実施例について図を参照して説明する。

第8図は本発明の一実施例を示すブリント配線 事板のめつき装置の構成図、第4図は第8図に示 す集光郷の外観図、第5図は本発明の一実施例に よつて測定されためつき面積を示す説明図である。

第8 図において、1 1 は 基板 8 8 上を 無明する 光源で、例えばハログンランプ等で構成し、 基板

33 Jan 40 8 5-

品質の良否を左右するめつき電視数定が問題となる。 この条件が適正でないと、めつき厚のばらつきによる品質が不安定でかつ焼付、はがれ等による不良品のも生はさけられず、製品コストの上昇はまれがれたかつた。

本発明の目的は、かかる欠点を除去し、 高精度 高能率なめつき面積を測定する機能を有するブリ ント配線基板のめつき装備を提供することにある。

本発明によれば、ブリント記線基板へのめつき 装置において、基板を一定速度で移送する基板 敷 送部と、光源11,15集光器12,16 および光電 素子14,18を前記基板の両側に配置し、前配基板 板表面のブリント配線パターンのめつき面積を検 出する第1, 第2面積検出部と、前配高1, 第2 面積検出部と一定間隔をおいて配置し、光源19 と果光器20 および光電素子22とを検記基板の 所面では、前配高板の を発表20 および光電素子22とを検記基板の で相対向させ、前配基板の が一本ののめつき面積を検出する第8面積 と、的記点1,第2 および第8面積機定回路と、 接続した第1,第2 および第8面積機定回路と、

1 賽

20

5

10

5

10

88に対して反射光を考慮して適正な角度に配置 してある。12は基板88からの反射光を集光器 で基板88に相対向させて設置してある。この集 光器 1 2 の受光面 102 は弱 4 凶に示すごとくオブ チカルファイバー104を密滑状態で直線状に配列 していて、オプチカルファイバー 104の配列巾L は基板88の巾よりもやや大きめにしてある。ま たとのオプチカルファイパー 104のファイパー 径 は面積測定における分解能を決定する因子でもあ るため、出力ロスおよび工作上の難易度を考慮し て最適に選択する必要がある。18は集光器12 からの光を絞るレンズであり、14は光エネルギ ーを電気エネルギーに変換する光電楽子で、例え ば光電子増倍管等で構成し、レンズ13の漁点に 合せて設置する。一方第3図に示すごとく基板88 の反対側の面に相対向している。1.5 は光源、16 は集光器、17はレンズ、18は光電業子で、光 源11,集光器12,レンズ18および光電素子 14と同一に構成されていて、基板88からの反

射光を検出する。一方19は、光源11かよび集

15

26

先掛12からある間隔をおいて配置した光顔で、 基板88の表面に相対向して設置し、例えばハコ **グンランブ等で構成する。20は第8図に示すど** とく基板 8 8 の 品品 取付穴 8 9 を介して光顔 1 9 からの光を集光しガイドする集光器で、集光器 12および16と何一に構成されている。この果 光器20は光源15および集光器16からある間 福を介して基板86の通過する延長上に配成し、 光振19とは基板88の通過する関膜をもつて相 対向させている。21は集光器20からの光を絞 るレンスで、レンズ18および17と同一に構成 している。22は光エネルギーを電気エネルギー に変換する光電素子で、光電素子14および18 と同一に構成していて、 碁板88の形品収付穴 8 9 からの光を検出する。 28, 25 および27は、 光電集子14 18 および22, 光張11, 15 および 19. 集光器 12. 16 および 20 に各々接続した第 1, 舞2かよび痛8 面積制定回路である。24, 26 かとび28は、前配第1、海2かよび承3 歯 機御足回路に各々接続しためつき面積を計算する

瞬の定数を設定する第1, 第2⇒よび第8定数数 定部である。29は第1、第22よび第8面機関 定回路 28, 25 および 27 に各々接続し、各々の 面積測定回路から入力される面積値を加算し、基 板 8 8 のめつき面積の総和を算出するめつき面積 加集器である。801はめつき面積加算器29代接 統し、めつき面積に対応しためつき電流値を制御 するコントローラである。81はコントローラ80 に接続し、めつき面積に対応した蓄板 8 8 へのめ つき電流値を数定する第4定数設定部である。82 はコントローラ80に接続し、基板88へのめつ き電流を発生させるめつき電源である。8 8 はめ つき電源82に接続しためつき槽である。85, 87は基板88の搬送用駆動ローラ、84,86は 撤送用駆動ローラ 8 5。8 7 と組合せたピンチロー ラである。この鐵送用瓜動ローラ 8 5, 8 7 とピン チローラ84、86とで構成された基板88の基板 搬送部は、めつき槽88に接続していて、基板88 を矢印101の方向に一定速度で移送し、めつき槽 28に撤送する。

20

15

10

次に本発明の一実施例のめつき装置の動作につ いて関節を参照して説明する。まず基板88は、 駆動ローラ85により一定速度で移送されて、 男 1. 病2面積検出部まで進すると、光反射式の検 出てあるために光観11および15から照射され た光は、基板88の表面、裏面の配線パターンの 面積に比例した量の光を反射する。この基板 8 8 から反射された光は集光器12,18を介してレン メ18,17に達する。この光はレンメ18,17に よつて絞られ、光端素子14,18に集められ、と の光の強度IK比例して光のエネルギーから電気 エネルギーに変換される。これらの関係を席る図 化示す。この第6関からも明らかのように反射光 の強度度を1、時間をTとすれば、電気出力105 による基板 8 8 の配線 図略部分の面積 106 の線和 は斜線で表わした面積となる。すなわち、これら を式で表わせば、反射光量型は $\mathbb{L} = \int_{-\pi}^{T_1} \mathbb{I} \, \mathrm{d} T \, \mathcal{E} \, x$ り、反射光量肌が、すなわち基板88の配線回路 面積である。との反射光量肌を等額的に面積に置 き変える定数数定部26,28には反射光量と面積

との関係を定故として設定しておき、第1. 第2面積例定回路 25. 27に入力された反射光量配を 顕数として面積を計算する。この関係を式で表わせば、基板 8 8 の両面の配線回路面積 S_A . 基板 8 8 の両面の配線回路面積 S_A . 基板 8 8 の片面ずつの配線回路面積を S_1 . S_3 . 反射光量を面積に 等価的に 置きかえる定数を K_A とすると、 S_A \Longrightarrow $S_1+S_2=K_A$ (E_1+E_2)が成立つ。

この場合、E_L = E₁ + E₂であり、E₁, E₂ は基板 88 の両面のそれぞれの反射光量であるが、この反射光量にが光電案子 1 4. 18 で光エネルギーから電気エネルギーに変換されていることは明確である。一方、基板 8 8 の動きに着目すれば、時間の経過と共に基板 8 8 は解 8 面積検出部に達すと、基板 8 8 にあけられている部品取付欠 8 9 を介して光源 8 8 から照射されている光が、部品取付欠 8 9 の穴数に比列した光量E₁として 4 8 面積検出部により、前述と同様の動作により検出される。これを式で楽わせは、

SB = KB EL が成立つ。

この場合に、Saは基板88の部品取付穴89の

10

断面積の総和で、Kaは透過光量Euを等価的に断面。 機に僕き変える定数,ELは邵品取付穴89からの 透過光量の総和である。これらの関係は用る図に 示す通りで、前述と同様に第8面積稠定回路27. 第8定数股定部28で収扱つて面積を算出する。 ただしこの場合に、第8定数数定部28において は、部品取付穴の1個の漫過光量に対し、断面積 を等価的に算出する定数としてのKBは、*R^BHが考 厳してあるととは云うまでもない。ことでRは、 部品取付穴89の半径、Hは基板88の厚さであ る。このようにして第1、第2をよび第8面模糊 定回路28, 25かよび27から算出された結果は、 めつき面積加算器29に各々独立して入力される ことにより、このめつき面積加算器29によつて 基板88のめつき面積の総和が算出される。 このめつき面積の飾和 S は、

8=8_A+8_Bという関係で示される。

このように求められた面積は、第4定数配定部 81に設定されている记数Keによりめつき条件に 変換され、すなわちめつき面積に対応した電流値

関面の詳細な説明

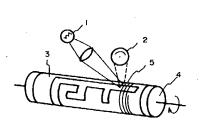
第1回かよび第2回は、従来一般にめつき面横 側足に使用されている反射光式および透過光式面 橙棚足器の構成凶、第8四は、本発明の一実施例 を示すプリント配舗基板のめつき美貴の構成図、 第4回は、第8回に示す集光部の外観図、第5回 は、本発明の一実施例によつて測定されためつき 面積を示す説明図である。とれらの図において、 1 は光欄、2 は光電条子、3 はネガフイルム、4 はドラム、5は走査線、6は光電点子、7は光源、 8はネガフイルム、9はガラス板、10は暗箱、 11,15,19 は光原、12,16,20 は集光端、 18.17,21 はレンズ、14,18,22 は光 電景子、 2 8 は第1 面積測定回路、24 は第1 定数股定部、 25 才第2面模例定国路、26 才第2 定数数定部、 27 は無8面疊剛定回路、28 は第8 定数股定部、 29はめつき面積加算器、80はコントローラ、 81 过第4 定数股定部、 82はめつき電源、 8 8 はめつき僧、 8 6, 37 は駆動ローラ、 84,86はピンチローラ、88は基板、

がコントローラ80を介してめつき電源82に設定され、所定の電流が落板88が搬送され設置しためつき帽88に供給される。このようにして、めつき帽88には所定の電流を一定時間通電し、めつき作業が完了する。しかるにめつき作業は以下とのサイクルを同様に繰返すだけである。なか、本説明では、説明を簡単にするために、めつき僧88は一種の例で説明したが、多層めつきする場合にも本発明が有効に適用されることは云うまでもない。

以上説明したよりに、本発明によれば、従来のオフラインでの非能率なめつき面積を求める作業を、オンラインで自動的に、しかも基板から直接面積を求めることにより作業能率が何上する。 さらには、従来の基板のネガフイルムからの面積 御足は精度が無く、本発明のごとく直接 基板から求めることでより精度が向上し、めつき条件が安定するため、品質かつ信頼性の向上がはかれる等多くの効果を発揮する。

89は部品取付穴である。

代期人 弁理士 内 原 晋



オー図

